



2026年3月4日
タツモ株式会社
経理部 IR 課

2025年12月期 決算説明会 Q&A

1. パワー半導体分野の前年比動向と収益性への影響を教えてください。

パワーは24年比で約半減まで落ち込み、売上に対する収益率悪化の主要因となっています。パワー向け装置は、複数台をまとめてプロセスと合わせて提案でき、付加価値が高くなっています。今期は回復を見込んでいます。

2. パワー半導体分野の売上動向と地域別需要の現況を教えてください。

パワー半導体向けは、半導体装置内売上の10%前後です。中国向けSiC関連の投資継続しており、今期は増収を見込んでいます。

3. 来期に向けた受注環境および業務ボリュームの見通しを教えてください。

大型案件の消化が中心だった昨年から今期は受注環境は変化している。個別引合いの増加による仕様の多様化に対応することで、売上・利益に転換を図るフェーズと考えている。複数案件に種をまき、リピート受注による更なる売上拡大に努めていきます。

4. 受注動向（足元～26年）および顧客セグメントの広がりを教えてください。

受注は昨年比プラスを想定している。先端パッケージを中心に受注を拡大し、パネルレベルパッケージ装置も拡販に努めて行く予定です。

5. 70億円の設備投資の内訳と減価償却見通しを教えてください。

設備投資70億円のうち、土地などの取得に約5分の2、デモ装置や検査機器等が約3分の1を予定しています。今期減価償却は14億円で、来期にかけて償却負担の大幅な増加は見込んでいません。まず、今後、新工場の計画が具体化された時点で適宜開示を行って行きます。

6. 今回の設備投資が業績に反映される時期（LAB/DTB 含む）を教えてください。

LAB は来期以降の売上伸長を見込んでいます。一方で、DTB は立ち上がりは2～3年後ろにずれの予予想です。

7. レーザー接合装置 LAB の用途と主要ターゲットを教えてください。

LAB は主として MEMS（ジャイロなどのセンサ等）向けキャビティ封止用途をターゲットとしています。異種材料接合（Si-ガラス等）や SiC キャリア貼付を伴うテンポラリーボンディング用途にも適用できます。先端パッケージ用途も検討しており、チップレット関連での活用可能性を探索中です。

以上